

深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于公司新项目研发取得重要进展的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、研发概要

近日，深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金信诺”）承接了上海诺基亚贝尔实验室的 5G 用高低频一体化测试天线（28GHz RF module 和 3.5GHz RF module）项目，目前已经完成了装配和初步测试，研发取得突破性进展。

二、研发进展情况

当前国内外业界正处于 5G 研究热潮，上海诺基亚贝尔实验室作为全球领先的通信设备厂商，为了验证其 5G 基带算法等需求，在获取公司具有 5G 毫米波射频前端设计经验和优势的情况下，对公司提出 5G 高、低频段射频前端的研制需求。

其中高频段一体化测试天线由 3 套 BS（基站端）和 1 套 MS（移动端）组成，低频段一体化测试天线由 1 套 BS（基站端）和 1 套 MS（移动端）组成。目前公司已经完成高、低频段 BS 和 MS 的射频前端研制，包括天线、射频链路、波控、电源等功能模块，并已经装配和初步测试，中频信号采集处理正在软件调试中。

三、对公司未来发展的影响

金信诺在该领域取得的进展性突破进一步证明了公司在 5G 高、低频段射频前端领域的研发实力，该项目的顺利研制，将会推进通信设备厂商、测试厂商和科研机构的 5G 平台原型样机研制进展，并且会对公司业绩产生积极的影响。

四、风险提示

上述研发项目进展不代表相关产品的量产，尚受市场需求、行业发展等多方面因素的影响，可能存在一定不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会

2019 年 1 月 22 日